



### 特性

- 》良好的热传导率：**6.0 W/mK**
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性，柔软兼有弹性，适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

### 应用

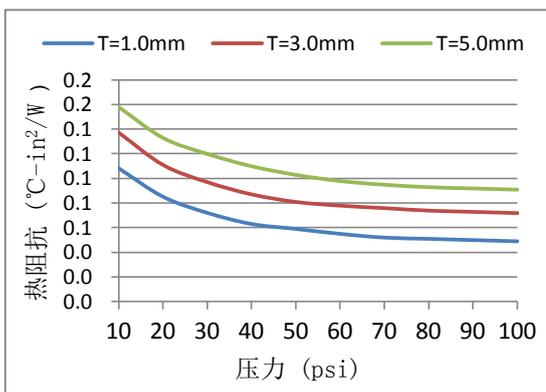
- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具
- 》显卡模组

TIF™700L-HM是一种填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

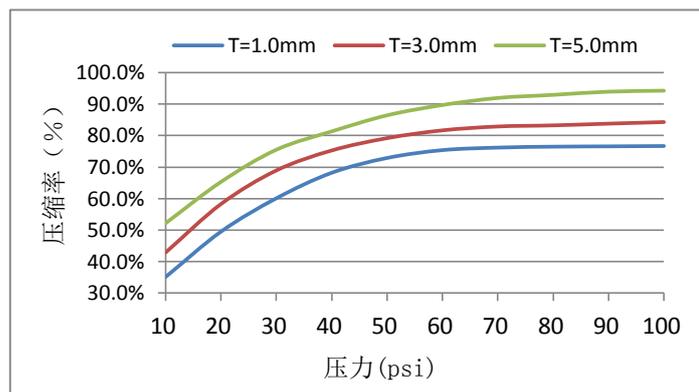
TIF™700L-HM 系列特性表

颜色	灰色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****
厚度范围	0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm)	ASTM D374
硬度	30 Shore 00	ASTM 2240
比重	3.3 g/cc	ASTM D297
使用温度范围	-45~200℃	*****
击穿电压(T= 1mm 以上)	>5500 VAC	ASTM D149
介电常数@1MHz	4.5 MHz	ASTM D150
体积电阻率	1.0X10 <sup>12</sup> Ohm-cm	ASTM D257
热传导率	6.0 W/mK	ASTM D5470
	6.0 W/mK	GB-T32064
总质量损失 (TML)	0.30%	ASTM E595
防火等级	94 -V0	UL E331100

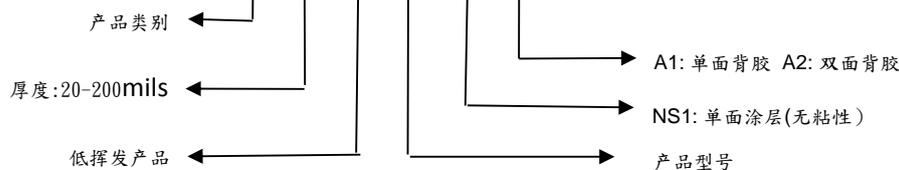
热阻抗



压缩率



产品型号说明：TIF7 00 - L - HM - NS1 - A1



导热介面材料  
应用技术下载



<http://www.ziitek.com>

### 产品规格

标准厚度: 0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm)      标准尺寸: 8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。欲了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

导热材料	发热材料	导热工程塑料	发泡硅胶	模切制品
加拿大: Tel: +001-604-2998559 E-mail: sales@thermazig.com		中国: Tel: +86-769-38801208 E-mail: frances@ziitek.com.tw		台湾: Tel: +886-2-22771007 E-mail: frances@ziitek.com.tw

以上资料与说明相信是可靠的,但不作为法律的解释或保证,用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品与应用。